

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者 |
| 时间 | 2026年06月09日 15:00-17:00 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事兼总经理 于浩 董事会秘书兼财务总监 郑帅男 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 2025年公司营业收入增长38.95%，增长的主要驱动因素是什么？2026年Q1增长16.13%，增速放缓的原因？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2025年公司营业收入增长38.95%，增长的主要驱动因素为半导体产业市场需求持续增长以及公司产品具备竞争优势。公司积极开拓市场，半导体专用温控设备、晶圆传片设备、零配件及支持性设备、维护维修服务均实现了较快增长。2026年第一季度营业收入同比增长16.13%，增速较2025年全年有所放缓，但仍保持了较快增长态势，主要系公司销售规模持续扩大，产品竞争力不断增强。具体情况请以公开披露信息为准，感谢您的关注。</p> <p>2. 请公司介绍一下2025年在研发团队建设和人才培养方面的举措，以及2026年Q1研发投入的最新情况？</p> |

答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视研发人才队伍建设,截至2025年末,公司拥有研发人员212人,占公司总人数的比例为20.87%,较上年的19.25%进一步提升。其中博士10人、硕士68人。公司提供“专业线与管理线”双通道人才发展路径,以激发创新积极性。2026年第一季度,公司延续高强度研发投入,研发费用达3,917.54万元,同比增长23.04%,占营业收入9.99%,为公司持续技术创新提供了有力保障。具体情况请以公开披露信息为准,感谢您的关注。

3.领导好,我想问下:公司在应对半导体技术迭代和更先进制程需求方面有哪些技术布局 and 研发进展?

答:尊敬的投资者,您好!公司始终紧跟行业技术发展趋势,持续加大研发投入。2025年公司研发投入1.40亿元,同比增长48.65%,占营业收入9.81%;2026年第一季度研发投入3,917.54万元,同比增长23.04%,占营业收入9.99%。截至2025年12月31日,公司累计获得专利437项,其中发明专利130项;2025年新增申请专利154项,获得专利98项。公司系国家级专精特新“小巨人”企业,并承担国家级重大专项课题(温控装置相关)。在研项目涵盖半导体专用温控设备(含低温至超低温系列)、工艺废气处理设备、晶圆传片设备等。公司根据行业技术趋势及客户需求持续推进研发,具体进展请以公开披露信息为准。感谢您的关注!

4.公司是否有计划通过并购 or 合作加速技术突破? 重点关注哪些领域?

答:尊敬的投资者,您好!公司持续高度关注市场环境和政策导向,将综合考虑发展战略、行业情况、业务协同等因素决定是否通过并购 or 合作方式加速技术突破。如未来有相关规划,公司将严格按照证监会、交易所的相关规定及时履行信息披露义务。具体情况请以公开披露信息为准,感谢您的关注。

5.余总,跟您请教下,咱们京仪装备如何保障供应链安全,关键零部件国产化进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视供应链安全,采取多项措施保障关键零部件的稳定供应:一是已建立完善的供应商评价与考核管理体系,搭建起完整的半导体专用设备采购供应链条,并不断优化供应链结构、推进供应商多元化,以此抵御外部环境带来的供应波动。同时,公司发力关键零部件自主研发,深耕核心技

术，不断提升产品技术实力与量产工艺水平，助力相关领域国产化替代。现阶段公司前五大供应商采购占比43.44%，供应链结构健康，整体风险处于可控范围。具体情况请以公开披露信息为准，感谢您的关注。

6. 安徽研发生产基地建设最新进度如何？投产后预计对公司产能和交付能力产生怎样的影响？

答:尊敬的投资者，您好！截至2025年底，公司募投项目安徽研发生产基地投资进度为49.16%，预计2026年12月达到可使用状态。项目建成后，将提升公司温控设备及废气处理设备的生产能力，并新增研发及办公设施。具体情况请以公开披露信息为准，感谢您的关注。

7. 公司赚钱了打算怎么给我们股东分红？

答:尊敬的投资者，您好！2025年度，公司实现归母净利润1.48亿元，拟每10股派发现金红利1.25元，合计分红2100万元，占归母净利润比例14.20%。本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。我们希望通过合理的利润分配，与广大投资者共享公司发展的成果，同时也向市场传递公司稳健发展的信心。具体情况请以公开披露信息为准，感谢您的关注。

8. 公司经营持续向好，是否有回购公司股票的打算？

答:尊敬的投资者，您好！公司管理层将综合考虑公司的发展战略、经营情况、财务状况等因素，论证回购股份的可行性及必要性。如后续有相关计划，我们将履行相应的决策程序和信息披露义务。具体情况请以公开披露信息为准，感谢您的关注。

9. 2025年公司期间费用变化情况如何？

答:尊敬的投资者，您好！2025年公司销售费用8,271.64万元，同比增长34.74%，主要系本期职工薪酬增加2,047.98万元；管理费用7,740.13万元，同比增长17.61%，主要系本期职工薪酬增加1,028.02万元；财务费用-135.13万元，上年同期为-915.93万元，变动主要系本期利息收入减少603.07万元；研发费用13,995.74万元，同比增长48.65%。公司期间费用的增长与业务规模扩张相匹配，费用管控总体合理。具体情况请以公开披露信息为准，感谢您的关注。

10. 随着先进封装及先进制程的发展对公司设备及产品有什么

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>影响？目前公司海外市场拓展情况如何？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！随着半导体芯片制程不断向更精细化方向演进，晶圆厂对生产环境温度控制精度和工艺废气处理效率的要求也同步提升。公司作为国内半导体专用温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备的主要供应商，产品已批量应用于国内最先进的逻辑芯片14nm及存储芯片192层等制程产线，深度受益于国产替代和产能扩张的双重驱动。2025年公司实现营业收入14.26亿元，同比增长38.95%；2026年第一季度实现营业收入3.92亿元，同比增长16.13%，保持了稳健增长态势。目前，公司的业务重心聚焦于国内市场，持续为半导体制造产业提供更先进处理能力、更高生产效率的半导体专用设备，为实现我国集成电路自主可控发展贡献力量。具体情况请以公开披露信息为准，感谢您的关注。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2026年06月09日</p> |